



2024年 头豹行业词条报告

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

企业竞争图谱：2024年半导体设备金属机械类零部件 头豹 词条报告系列



于利蓉

2025-01-03 未经平台授权，禁止转载

摘要 中国半导体设备金属机械类零部件行业技术密集度高，具有高精度及高可靠性、种类多、覆盖范围广等特点。行业受益于中国大陆晶圆厂扩产和下游半导体设备市场发展，市场规模不断扩大，中国设备厂商崛起。未来，国家政策支持 and 国产替代趋势将进一步推动行业发展，同时5G、IoT、AI等高新技术的发展也将为下游半导体消费产品带来新的增量需求，预计2024年中国半导体设备金属机械类零部件市场规模将持续扩大。

行业定义

半导体设备零部件是指在半导体设备制造过程中所需的零部件，并在材料、结构、工艺、品质和精度、可靠性及稳定性等方面能达到半导体设备的技术要求。其中，半导体机械类零部件在设备中起到构建整体框架、基础结构、晶圆反应环境和实现零部件特殊功能的作用，保证反应良率，延长设备使用寿命。半导体设备机械类零部件进一步细分主要包括金属件、石英件、陶瓷件等，其中，金属件占比最高。**半导体设备金属机械类零部件是指反应腔、传输腔、过渡腔、内衬、匀气盘、托盘、冷却板、底座、铸钢平台等金属类半导体机械类零部件。**

行业分类

按照功能用途的分类方式，半导体设备金属机械类零部件行业可以分为如下类别：

半导体设备金属机械类零部件基于功能用途的分类

金属工艺件、金属结构件

金属工艺件

反应腔、传输腔、过渡腔、内衬、匀气盘等。其中，腔体是半导体设备中参与晶圆制备反应工序的关键部件，为晶圆生产提供耐腐蚀、洁净和高真空环境。内衬通常为薄壁型金属部件，是安装在刻蚀腔体内部的衬套型部件，保护腔体免受腐蚀性工艺环境的影响，降低腔体制造成本、提升腔体使用寿命。匀气盘直接参与晶圆反应，特种工艺气体通过匀气盘上的小孔后均匀沉积在晶圆表面，保证晶圆表面膜层的均匀性和一致性。

金属结构件

托盘、冷却板、底座、铸钢平台等。这些产品在性能上主要对密封性能、洁净度、机械加工精度、结构强度等有较高要求。

行业特征

半导体设备金属机械类零部件的行业特征包括技术密集，高精度及高可靠性、多学科交叉融合，复合技术人才需求高、碎片化特征明显，不同工艺种类间壁垒高。

1 技术密集，高精度及高可靠性

相比于其他行业的基础零部件，半导体设备金属机械类零部件需用于精密的半导体制造，其尖端技术密集的特性尤其明显，有着精度高、批量小、多品种、尺寸特殊、工艺复杂、要求极为苛刻等特点。

2 多学科交叉融合，复合技术人才需求高

半导体设备金属机械类零部件种类多，覆盖范围广，产业链较长，其研发设计、制造和应用涉及到材料、机械、物理、电子、精密仪器等跨学科的交叉融合，因此对于复合型人才有很大需求。

3 碎片化特征明显，不同工艺种类间壁垒高

由于半导体设备金属机械类零部件市场分支领域较多，生产工艺对于研发周期和资金投入要求较高，碎片化特征明显，单一产品的市场空间很小，同时技术门槛较高，半导体零部件公司多专注于某一细分工艺或产品，呈现“小而精”的特点。

发展历程

中国半导体设备金属机械类零部件行业起步较晚。以先锋精科发展历程来看中国半导体设备金属机械类零部件行业发展历程，中国半导体设备金属机械类零部件行业约起步于21世纪初，中国企业开始研制半导体设备金属机械类零部件；2012年之后中国半导体设备金属机械类零部件企业开始量产交付；2018年之后中国企业技术水平逐渐追赶国际企业，进入快速发展期。

2008-01-01~2011-01-01

2008年，先锋精科成立，成为中微公司供应商，提供金属耗品备件；2011年，成功研制千余种零部件表面处理样件并交付，成为北方华创供应商。中国半导体设备金属机械类零部件行业开始起步。

启动期 · 2012-01-01~2017-01-01

先锋精科供应中微CCP电容性高能等离子体刻蚀设备腔体超百台，核心产品应用于中国自主研发的第一批7nm芯片刻蚀机。中国半导体设备金属机械类零部件行业初具规模，开始批量供应下游市场。

高速发展期 · 2018-01-01~至今

2018年10月，“2018年中国半导体材料及零部件创新发展大会”(以下简称“大会”)在宁波市北仑区隆重召开；先锋精科迭代升级硬质阳极氧化技术，增强阳极氧化技术，完成半导体钣金及模组装配研发，拥有自动化产线，累计开发新品40000+，形成金属零部件精密机械制造技术、焊接技术、高端器件的设计及开发技术、定制化工装开发技术等多项技术；2024年，先锋精科上市。

中国半导体设备金属机械类零部件行业出现以先锋精科为代表的一批半导体设备精密金属零部件企业，技术水平逐渐追赶国际企业。

产业链分析

半导体设备金属机械类零部件发展现状

半导体设备金属机械类零部件行业产业链上游为原材料，主要包括铝、不锈钢、镍等金属；产业链中游为半导体设备金属机械类零部件的制造环节；产业链下游为应用环节，主要应用于半导体设备，包括刻蚀设备和薄膜沉积设备等。

半导体设备金属机械类零部件行业产业链主要有以下核心研究观点：

上游原材料占比较大，约45%，原材料价格波动将会影响中游企业的成本和毛利；高端金属零部件制造原材料依赖进口。

半导体设备金属机械类零部件原材料主要包括铝、不锈钢、镍等金属，原材料在成本中占比较高，以先锋精科为例，2021~2023年直接材料占公司主营业务成本的比例较高，约45%左右。此外，由于大宗金属原材料价格易受宏观环境、经济周期、市场需求、汇率等因素的影响，故价格波动可能性较大，原材料价格的波动将会影响中游企业的成本和毛利。此外，从原材料端来看，高端金属零部件制造原材料如铝合金金属、钨钼金属等多被美国、日本公司垄断供应，进口依赖度高，主要是由于中国高端铝合金领域科技供给质量不高，正向研发能力弱，缺乏具有自主知识产权的铝合金材料体系，导致高端金属零部件制造原材料进口依赖度高。

中游市场集中度较低，国产替代趋势明显。

中国半导体设备金属机械类零部件市场，由于零部件种类繁多，目前业内多数企业仅专注于特定生产工艺或特定零部件产品，行业碎片化特征显著，集中度较分散。受益于中国半导体设备行业国产替代的趋势，中国半导体设备金属机械类零部件产业也迎来下游厂商需求增加的机遇，有望凭借地理优势和成本优势加速国产替代进程。

上 半导体设备金属机械类零部件产业链上游分析

生产制造端

原材料，主要包括铝、不锈钢、镍等金属。

上游厂商

股 苏州美德航空航天材料有限公司

股 无锡恒泰航空航天科技有限公司

股 苏州首铝金属有限公司

股 靖江佳仁半导体科技有限公司

股 苏州市乐了精密机械制造厂

股 靖江新恒和半导体科技有限公司

股 苏州锴璞拓纬机械设备有限公司

股 无锡元基精密机械有限公司

股 优密铝业（苏州）有限公司

产业链上游分析

原材料占比较高，价格易受宏观环境、经济周期、市场需求、汇率等因素的影响出现较大波动。

半导体设备金属机械类零部件原材料主要包括铝、不锈钢、镍等金属，原材料在成本中占比较高，以先锋精科为例，2021~2023年直接材料占公司主营业务成本的比例分别为44.00%、47.04%和45.97%，占比较高，约45%左右。此外，由于大宗金属原材料价格易受宏观环境、经济周期、市场需求、汇率等因素的影响，故价格波动可能性较大，原材料价格的波动将会影响中游企业的成本和毛利。

高端金属零部件制造原材料依赖进口。

由于中国工业长期受“重主机、轻配套”的思想影响，零部件上下游配套领域的投入力度严重不足，导致中国在零部件的原材料和生产装备上就与国外拉开差距。例如目前半导体金属零部件常用的高精度加工中心，中国在加工精度、加工稳定性、几何灵活度等方面都落后于国外。从原材料端来看，高端金属零部件制造原材料如铝合金金属、钨钼金属等多被美国、日本公司垄断供应，进口依赖度高，主要是由于中国高端铝合金领域科技供给质量不高，正向研发能力弱，缺乏具有自主知识产权的铝合金材料体系，导致高端金属零部件制造原材料进口依赖度高。

中 半导体设备金属机械类零部件产业链中游分析

品牌端

半导体设备金属机械类零部件的制造环节。

中游厂商

股 江苏先锋精密科技股份有限公司

股 沈阳富创精密设备股份有限公司

股 苏州华亚智能科技股份有限公司

股 宁波江丰电子材料股份有限公司

股 苏州珂玛材料科技股份有限公司

股 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

股 浙江晶盛机电股份有限公司

股 托伦斯

股 京鼎精密

股 超科林

股 靖江市先锋电机制造有限公司

产业链中游分析

半导体设备机械类零部件中，金属件占比最高，市场集中度较分散。

半导体机械类零部件在设备中起到构建整体框架、基础结构、晶圆反应环境和实现零部件特殊功能的作用，保证反应良率，延长设备使用寿命。半导体设备机械类零部件进一步细分主要包括金属件、石英件、陶瓷件等，其中，金属件占比最高，约为50%或更多。半导体设备金属机械类零部件市场集中度较分散，行业主要企业有日本的Ferrotec、中国台湾地区的京鼎精密、美国的超科林、中国先锋精科、靖江先锋、江丰电子等，由于零部件种类繁多，目前业内多数企业仅专注于特定生产工艺或特定零部件产品，如靖江先锋专业于精密金属零部件生产制造，托伦斯专业于各种铝合金及不锈钢腔体、轴类零件等精密零部件的加工，江丰电子专业于PVD、CVD、CMP、清洗机等多种设备的零部件产品，先锋精密专业于刻蚀设备和薄膜设备的金属机械类零部件产品，行业碎片化特征显著。

中国企业具有本土优势，国产替代趋势明显。

受益于中国半导体设备行业国产替代的趋势，中国半导体设备金属机械类零部件产业也迎来下游厂商需求增加的机遇。相较于国外企业，中国半导体设备金属机械类零部件行业企业具有地理优势和成本优势。一方面，中国零部件厂商靠近终端市场便于零部件返修，且交货周期易于控制；另一方面，中国零部件厂商由于运费成本以及关税等因素影响，成本具有一定优势。据数据显示，2023年度中国大陆半导体设备销售额为366亿美元，同比增长29%，中国大陆半导体行业资本开支在加速上升，中国半导体设备国产化替代浪潮将首先利好中国本土半导体设备龙头企业，并进一步利好以本土半导体核心设备龙头客户为主要收入来源的半导体设备金属机械类零部件企业。

下 半导体设备金属机械类零部件产业链下游分析

渠道端及终端客户

应用环节，主要应用于半导体设备，包括刻蚀设备和薄膜沉积设备等。

渠道端

股 北方华创科技集团股份有限公司

股 中微科技控股有限公司

股 拓荆科技（上海）有限公司

股 华海清科（上海）半导体有限公司

股 中芯国际控股有限公司

股 北京屹唐半导体科技股份有限公司

产业链下游分析

刻蚀设备和薄膜沉积设备市场是半导体设备金属机械类零部件的重要下游市场。

在半导体制造过程中，刻蚀设备和薄膜沉积设备是技术难度仅次于光刻设备的两大核心设备，价值量合计约占半导体设备市场的40%。刻蚀设备和薄膜沉积设备市场是半导体设备金属机械类零部件的重要下游市场。先锋精科是半导体设备金属机械类零部件市场的中国代表企业之一，在刻蚀设备领域，先锋精科主要提供以反应腔室、内衬为主的系列核心配套件，并是中国少数已量产供应7nm及以下国产刻蚀设备关键零部件的供应商，能直接与国际厂商竞争；在薄膜沉积领域，先锋精科主要提供加热器、匀气盘等核心零部件及配套产品。2023年，先锋精科已量产应用在刻蚀设备的关键工艺部件在中国境内同类产品的细分市场规约为7.77亿元，细分市场占比超过15%；已量产应用在薄膜沉积设备的关键工艺部件在中国境内同类产品的细分市场规约为11.20亿元，细分市场占比超过6%。

行业规模

半导体设备金属机械类零部件行业规模的概况

2019年—2023年，半导体设备金属机械类零部件行业市场规模由8.41亿美元增长至23.14亿美元，期间年复合增长率28.81%。预计2024年—2028年，半导体设备金属机械类零部件行业市场规模由30.32亿美元增长至89.29亿美元，期间年复合增长率31.00%。

半导体设备金属机械类零部件行业市场规模历史变化的原因如下：

受益于中国大陆晶圆厂成熟制程扩产影响，中国半导体设备金属机械类零部件行业市场空间广阔。

受益于中国大陆晶圆厂成熟制程扩产影响，中国半导体设备在中国大陆晶圆厂的市占率从2020年的9.97%提升至2023年的33.11%，国内设备厂商正不断崛起，包括北方华创、盛美半导体、中微公司、上海微电子装备等半导体设备龙头企业，中国半导体设备市场作为半导体设备金属机械类零部件的下游应用市场，下游市场扩容带来上游半导体设备金属机械类零部件市场的持续发展。

受下游半导体行业整体发展态势影响，中国半导体设备金属机械类零部件行业发展向好。

半导体设备金属机械类零部件行业是半导体行业上游，半导体行业的整体发展情况会对半导体设备金属机械类零部件行业产生较大影响。受扩产周期、创新周期等因素的叠加作用，半导体行业具有典型的周期性特点，通常每4-5年完成一轮周期波动，呈螺旋式上升的特点，其中2-3年处于上行通道，3-6个季度处于下行通道。在经历了2021-2022H1的较快增长后，2022H2由于下游消费电子需求疲软，产能紧张时期的供应链库存累积，全球半导体市场进入下行周期，该下行周期在2023年下半年起逐渐复苏，从而影响半导体设备金属机械类零部件行业2022年市场规模出现短暂下行，2023年逐渐复苏。

半导体设备金属机械类零部件行业市场规模未来变化的原因主要包括：

国家产业政策支持，国产替代迎来红利。

为推动中国半导体产业的发展，中国政府先后设立国家重大专项和国家集成电路产业投资基金，地方政府也推出集成电路投资基金，推动中国半导体产业的发展。伴随国家鼓励类产业政策和产业投资基金不断落地，中国半导体相关产业迎来发展红利。目前，半导体设备零部件行业中，美国、日本公司处于垄断优势地位，中国厂商起步晚，处于追赶态势，半导体零部件国产化水平较低，仍存在较大的发展空间。近年来美国对中国半导体行业颁布一系列限制措施，限制领域涉及半导体行业下游应用及上游制造多个环节，使得中国半导体设备厂商进一步加快“去A化”步伐，在政策友好的半导体产业环境下积极开展研发工作，加快国产替代进程。

5G、IoT、AI等高新技术的发展，为下游半导体消费产品带来新的增量需求

2023年中国大陆半导体设备市场规模达到创纪录的342亿美元，增长8%，全球占比达到30.3%。半导体设备市场增长受益于半导体制造需求，5G、IoT、AI等高新技术的发展，为下游半导体消费产品带来新的增量需求。同时，随着半导体微缩制程要求提高，半导体设备的需求和价格持续高涨，未来半导体设备市场规模将持续扩大，预计2024年中国大陆半导体设备市场规模将达到375亿美元，增长9.6%，对于半导体设备及零部件行业巨大的需求将为半导体设备及精密零部件供应商提供广阔的发展机遇。

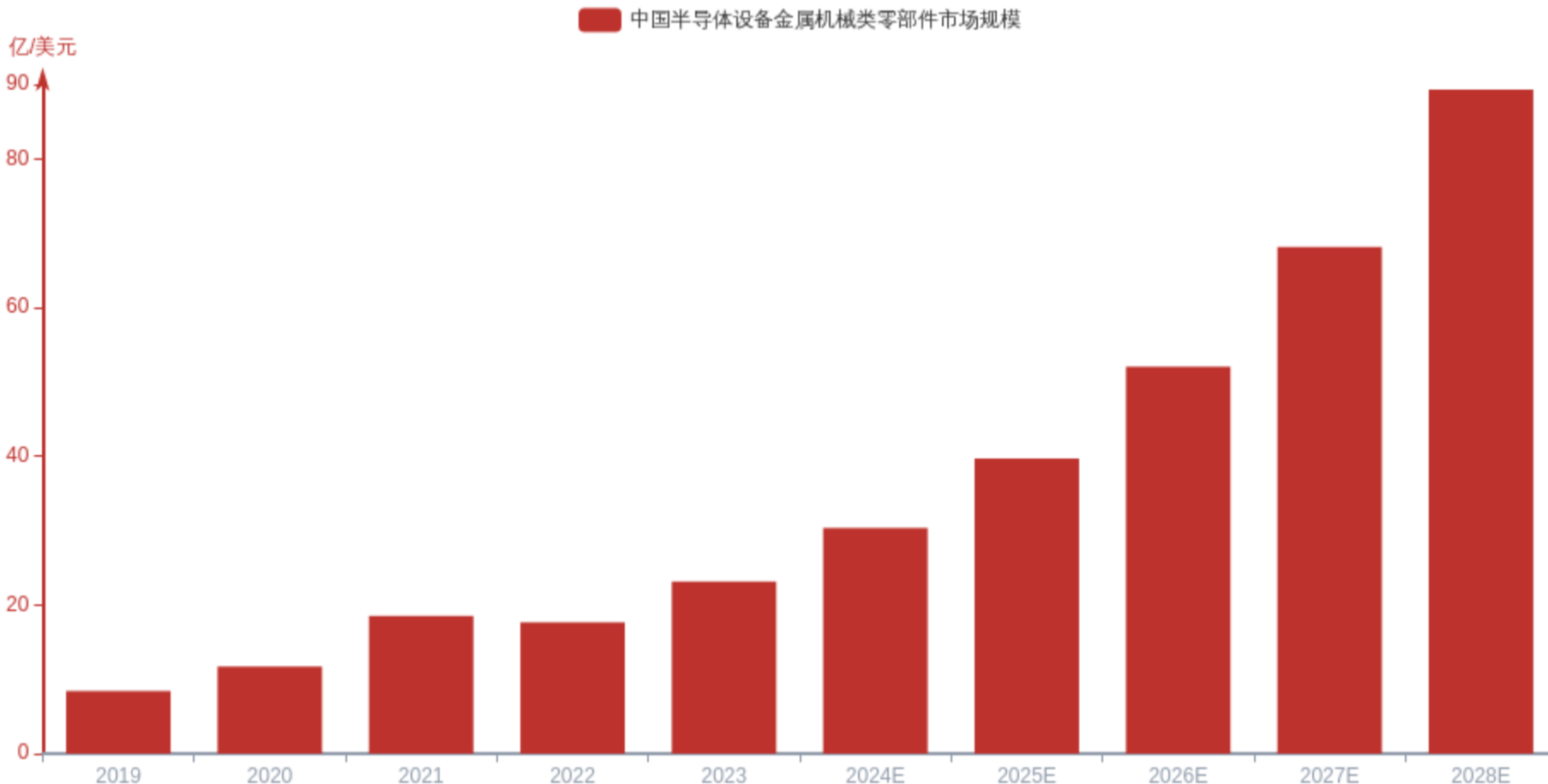
半导体设备金属机械类零部件规模预测

仅提供预测模型的PPTx格式文件下载

规模预测SIZE模型

半导体设备金属机械类零部件行业规模

中国半导体设备金属机械类零部件市场规模



计算规则:

数据来源: 先锋精科招股书、北京京仪招股书

政策梳理

政策名称	颁布主体	生效日期	影响
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	全国人大	2021-03-01	7
政策内容	集中优势实现集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，集成电路先进工艺和绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破，先进存储技术升级，碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展。		
政策解读	国家重视集成电路领域关键零部件的研发和关键材料的技术突破，集成电路领域作为国家重点关注的科技前沿领域受到政策支持，对于半导体关键金属零部件的发展具有产业带动作用。		
政策性质	规划类		

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《“十四五”智能制造发展规划》	工信部、发改委、教育部、科技部、财政部、人社部、市监局、国务院、国有资产监督管理委员会	2021-12-01	6
政策内容	大力发展智能制造装备。针对感知、控制、决策、执行等环节的短板弱项，加强用产学研联合创新，突破一批“卡脖子”基础零部件和装置。			
政策解读	《“十四五”智能制造发展规划》提出要大力发展智能制造装备，突破“卡脖子”基础零部件和装置，为半导体行业从事半导体设备精密零部件研发和生产的企业发展提供有力政策支持。			
政策性质	规划类			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》	中共中央、国务院	2022-12-01	6
政策内容	在人工智能、量子信息、脑科学等前沿领域实施一批前瞻性、战略性国家重大科技项目。聚焦核心基础零部件及元器件、关键基础材料、关键基础软件、先进基础工艺和产业技术基础，引导产业链上下游联合攻关。全面提升信息技术产业核心竞争力，推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新。			
政策解读	对于集成电路行业提升产业链集成能力具有重要指导意义。政策中提到的发展核心基础零部件及元器件、关键基础材料、先进基础工艺等尤其对于集成电路上游企业具有推动作用。			
政策性质	规划类			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《制造业可靠性提升实施意见》	工业和信息化部、教育部、科技部、市场监管总局	2023-06-01	7
政策内容	聚焦核心基础零部件和元器件，促进产业链、创新链、价值链融合，借鉴可靠性先进经验，着力突破重点行业可靠性短板弱项，推动大中小企业“链式”发展。聚焦机械、电子、汽车等行业，实施基础产品可靠性“筑基”工程，筑牢核心基础零部件、核心基础元器件、关键基础软件、关键基础材料及先进基础工艺的可靠。			
政策解读	对于半导体行业，精密零部件通常有通用件和定制件，政策指出要促进产业链、创新链、价值链融合，对于半导体精密零部件的研发具有重要推动作用。			
政策性质	指导类			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于印发电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案的通知》	国务院工业和信息化部、财政部	2023-08-01	6
政策内容	面向数字经济等发展需求，优化集成电路、新型显示等产业布局并提升高端供给水平，增强材料、设备及零配件等配套能力。			
政策解读	该政策进一步强调集成电路行业面向数字经济发展需求，布局并提升高端供给水平，对于半导体精密零部件的研发和生产提出更高端要求。			
政策性质	指导类			

竞争格局

半导体设备金属机械类零部件概况

由于半导体设备零部件行业整体集中度较为分散，目前行业内领先企业主要来自欧洲、美国和日本等地区；且目前中国业内多数企业仅专注于特定生产工艺或特定零部件产品，行业碎片化特征显著；其中先锋精科是中国半导体刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造专家。

半导体设备金属机械类零部件行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有日本的Ferrotec、中国台湾京鼎精密、美国的超科林、中国先锋精科等；第二梯队公司为富创精密、华亚智能、江丰电子等；第三梯队为其他中小企业。

半导体设备金属机械类零部件行业竞争格局的形成主要包括以下原因：

国外企业进入市场较早，具有先发优势和技术优势；中国零部件企业起步较晚，正加速追赶。

国外企业如Ferrotec于1980年在日本注册成立，进入市场较早，主营半导体硅片、半导体设备精密零部件、光伏电池及电子设备等业务，其旗下的杭州大和热磁电子有限公司为半导体设备精密零部件业务主要经营实体，是国际半导体设备企业的直接供应商，在半导体设备零部件市场凭借技术优势建立稳定的供应网络。中国企业如先锋精科成立于2008年，进入市场较晚，近年来不断加大技术研发，2021~2023年研发费用分别为1,341.45万元、2,154.10万元和3,097.44万元，复合增长率达51.95%，实现技术突破，加速追赶国外领先企业的技术水平，例如，先锋精科的关键工艺部件——腔体、匀气盘等已批量生产的应用于中微公司7nm及以下制程芯片生产线的CCP刻蚀设备及其氮化镓基LEDMOCVD设备领域。

精密机械零部件制造作为国家装备制造业整体水平的重要衡量标准，中国精密机械零部件制造企业得到政策大力扶持。

精密机械零部件制造作为一个国家装备制造业整体水平的重要衡量标准，其品类丰富性、功能性、质量技术水平决定了机械设备整体的性能、质量与可靠性。近年来中国政府持续为精密机械零部件推出多项扶持政策，有力推动半导体设备金属机械类零部件市场的发展。2021年，工信部、国家发改委等八部门印发《“十四五”智能制造发展规划》的通知，通知中提出大力发展智能制造装备。针对感知、控制、决策、执行等环节的短板弱项，加强用产学研联合创新，突破一批“卡脖子”基础零部件和装置。在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提到，在高端装备制造等重点领域和关键环节部署一批重大科技攻关项目，努力攻克一批关键核心技术、“卡脖子”技术，加快关键零部件国产化替代。半导体设备金属机械类零部件作为“卡脖子”基础零部件制造领域的细分市场，行业企业得到政策的大力扶持。

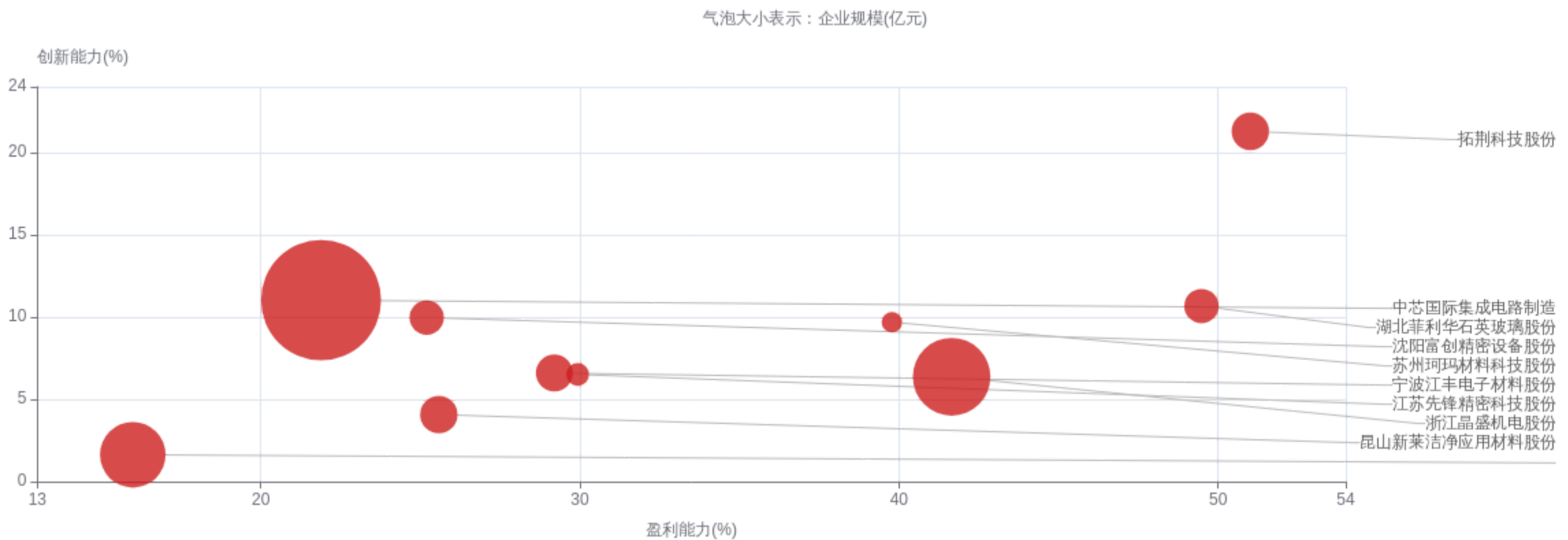
半导体设备金属机械类零部件行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因：

随着全球半导体行业的快速发展和中国半导体领域国产替代进程的不断加速，行业参与者竞争加剧。

随着全球半导体行业的快速发展，对于半导体设备零部件的需求不断增加，将会吸引越来越多的市场参与者积极开展半导体设备金属机械类零部件领域的投资，抢夺市场份额，如包括富创精密、江丰电子、新莱应材等在内的多家A股上市公司，已积极投入半导体零部件领域。同时行业内领先的企业通过并购重组进一步整合资源，使得市场竞争更加激烈。如富创精密拟收购亦盛精密100%股权，扩大在半导体零部件行业业务；江丰电子700万收购北京睿昇56%股权，加快半导体精密零部件业务的发展。目前，中国半导体设备精密零部件市场主要由美国、日本和中国台湾地区的企业占据主导地位。此外，随着中国半导体领域国产替代进程的不断加速，预计将有更多国产零部件厂商加入市场竞争，从而使半导体设备金属机械类零部件行业竞争加剧，市场集中度逐渐提高。

全球半导体竞争加速区域化重塑，中国国产替代趋势有望推动中国企业行业市占率提升。

全球各主要经济体纷纷在半导体产业政策方面加力，如自2022年以来，美国、欧盟、日本、韩国等国家和地区纷纷发布各自的芯片法案，聚焦自身在半导体设计与代工封测、生产与消费、设备与制造等领域的不平衡态势，计划通过大规模激励措施和产业扶持资金，鼓励本土芯片研发、生产，在提升需求自给率的同时，谋求相较于主要竞争对手的产业优势和技术优势。相较于此前效率优先的产业布局，供应链的独立性、多元化和安全性正在逐步成为各国半导体产业发展战略的优先考量。这一态势不仅影响全球半导体产业链供应链和产能分布，同时对半导体产业的发展趋势也将造成深远影响。“本地生产、本地用”成为当前主要经济体发展半导体产业的主流理念。中国政府也积极推动中国半导体行业产业链一体化建设，中国半导体行业零部件国产替代趋势的发展，有望推动中国半导体设备金属机械类零部件企业市场占有率提升。



上市公司速览

江苏先锋精密科技股份有限公司 (688605)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	5.6亿元 >	-	-

苏州珂玛材料科技股份有限公司 (301611)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	6.2亿元 >	74.7	59.4

沈阳富创精密设备股份有限公司 (688409)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	7.0亿元 >	105.5	25.4

宁波江丰电子材料股份有限公司 (300666)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	26.3亿元 >	41.8	30.0

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 (300260)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	21.6亿元 >	9.3	25.0

浙江晶盛机电股份有限公司 (300316)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	134.6亿元 >	80.4	42.0

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 (300395)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	14.9亿元 >	17.3	50.5

中芯国际集成电路制造有限公司 (688981)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	213.2亿元 >	-13.3	22.4

拓荆科技股份有限公司 (688072)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	-	-	-

华海清科股份有限公司 (688120)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	24.5亿元 >	33.2	45.8

企业分析

1 江苏先锋精密科技股份有限公司【688605】

公司信息

企业状态	存续	注册资本	15178.4856万人民币
企业总部	泰州市	行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
法人	游利	统一社会信用代码	91321282673031370B
企业类型	股份有限公司 (外商投资、未上市)	成立时间	1205942400000
品牌名称	江苏先锋精密科技股份有限公司	经营范围	许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；专用设备修理；模具制造；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据分析

财务指标	2020	2021	2022	2023	2024(Q1)	2024(Q3)
销售现金流/营业收入	0.55	0.73	1.06	0.85	/	/
扣非净利润同比增长(%)	/	/	/	/	/	/
资产负债率(%)	51.1114	39.6136	28.397	30.5408	/	/
营业总收入同比增长(%)	/	110.1999	10.8746	18.7344	/	/

归属净利润同比增长(%)	/	373.5745	-0.3775	-23.3947	/	/
摊薄净资产收益率(%)	/	/	/	/	/	/
实际税率(%)	/	/	/	/	/	/
应收账款周转天数(天)	188.9829	123.4176	126.0765	120.655	/	/
预收款/营业收入	/	/	/	/	/	/
流动比率	1.4702	2.1686	2.7902	2.4791	/	/
每股经营现金流(元)	0.7426	0.1954	0.36	0.9	/	/
毛利率(%)	39.1632	38.2982	39.1688	29.9343	/	/
流动负债/总负债(%)	81.7779	89.3335	85.3552	89.5728	/	/
速动比率	1.1845	1.7891	2.0072	1.8759	/	/
摊薄总资产收益率(%)	-9.3933	16.5271	11.8217	8.1094	/	/
营业总收入滚动环比增长(%)	/	/	/	/	/	/
扣非净利润滚动环比增长(%)	/	/	/	/	/	/
加权净资产收益率(%)	-26.84	42.28	17.92	11.55	/	/
基本每股收益(元)	/	/	0.7	0.53	0.31	1.15
净利率(%)	-19.0772	24.829	22.3092	14.3935	/	/
总资产周转率(次)	0.4924	0.6656	0.5299	0.5634	/	/
归属净利润滚动环比增长(%)	/	/	/	/	/	/
每股净资产(元)	/	/	/	/	/	/
每股公积金(元)	5.6432	5.2692	2.9957	3.0764	/	/
扣非净利润(元)	/	/	/	/	/	/
存货周转天数(天)	143.5407	113.536	181.7723	160.8507	/	/
营业总收入(元)	201545240.59	423647938.47	469718157.31	557716937.8	216466127.34	868890965.94
每股未分配利润(元)	6.3245	1.6919	0.2589	0.7253	/	/
稀释每股收益(元)	/	/	0.7	0.53	0.31	1.15
归属净利润(元)	-38449268.19	105187398.8	104790345.67	80274953.69	46784796.48	175078443.07
扣非每股收益(元)	/	/	/	/	/	/
毛利润(元)	/	/	/	/	/	/
经营现金流/营业收入	0.7426	0.1954	0.36	0.9	/	/

公司竞争优势

竞争优势

江苏先锋精密科技股份有限公司是中国半导体刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造专家，尤其在国际公认的技术难度仅次于光刻设备的刻蚀设备领域。公司是国内少数已量产供应7纳米及5纳米国产刻蚀设备关键零部件的供应商，直接与国际厂商竞争。在聚焦半导体领域的同时，公司充分发挥精密零部件技术的扎实基础及创新能力，积极在光伏、医疗等其他领域探索和开发新产品。

先锋精科官网

2 沈阳富创精密设备股份有限公司【688409】

公司信息

企业状态	存续	注册资本	30802.7995万人民币
企业总部	沈阳市	行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
法人	郑广文	统一社会信用	91210112675314948L

		代码	
企业类型	其他股份有限公司(上市)	成立时间	1214236800000
品牌名称	沈阳富创精密设备股份有限公司	经营范围	许可项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，半导体器件专用设备制造，金属表面处理及热处理加工，金属切割及焊接设备制造，金属加工机械制造，增材制造，3D打印服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

■ 财务数据分析									
财务指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024(Q1)	2024(Q2)	2024(Q3)
销售现金流/营业收入	0.93	0.92	0.85	0.74	0.8	0.71	/	/	/
扣非净利润同比增长(%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
资产负债率(%)	45.5153	49.7713	37.1595	56.0017	28.1847	37.2863	/	/	/
营业总收入同比增长(%)	/	12.6348	89.9413	75.207	83.1825	33.7523	/	/	/
归属净利润同比增长(%)	/	-585.9007	380.4252	35.2781	94.1936	-31.2756	/	/	/
摊薄净资产收益率(%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
实际税率(%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
应收账款周转天数(天)	84.4421	88.6715	75.2585	101.2488	106.7269	126.966	/	/	/
预收款/营业收入	/	/	/	/	/	/	/	/	/
流动比率	1.885	1.3228	2.5141	1.5637	5.2295	3.4306	/	/	/
每股经营现金流(元)	0.125	0.3874	1.12	1	-0.1068	-1.8482	/	/	/
毛利率(%)	33.2447	17.1831	31.5767	32.0374	32.6761	25.1991	/	/	/
流动负债/总负债(%)	46.4915	45.9329	44.4685	45.7634	45.1292	41.9924	/	/	/
速动比率	1.4103	0.8036	1.9554	1.1625	4.5983	2.6682	/	/	/
摊薄总资产收益率(%)	0.9345	-4.2464	8.1476	6.1559	5.1418	2.3607	/	/	/
营业总收入滚动环比增长(%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
扣非净利润滚动环比增长(%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
加权净资产收益率(%)	1.93	-8.33	14.76	12.9	12.19	3.61	/	/	/
基本每股收益(元)	0.06	/	0.65	0.81	1.45	0.81	0.29	0.55	0.76
净利率(%)	3.0508	-13.1612	19.4309	14.4044	15.1928	8.131	/	/	/
总资产周转率(次)	0.3063	0.3226	0.4193	0.4274	0.3384	0.2903	/	/	/
归属净利润滚动环比增长(%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
每股净资产(元)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
每股公积金(元)	2.5353	2.797	4.5928	4.6252	19.2464	19.4072	/	/	/
扣非净利润(元)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
存货周转天数(天)	176.8709	148.4219	128.1276	122.8334	137.6515	169.1729	/	/	/

营业总收入(元)	224931584.39	253351200.44	481218477.7	843128232.4	1544463324.83	2065755897.63	701476021.12	1506301561.67	2314895117.07
每股未分配利润(元)	-0.4751	-0.7032	0.2175	0.9225	1.7183	1.7099	/	/	/
稀释每股收益(元)	0.06	/	0.65	0.81	1.45	0.81	0.29	0.55	0.76
归属净利润(元)	6862307.1	-33343998.53	93504971.18	126491769.15	245638859.35	168687890.83	60429613.63	121800794.37	189732352.52
扣非每股收益(元)	/	/	/	/	1.05	0.41	/	/	/
毛利润(元)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
经营现金流/营业收入	0.125	0.3874	1.12	1	-0.1068	-1.8482	/	/	/

公司竞争优势

竞争优势

沈阳富创精密设备股份有限公司成立于2008年，2022年10月成为科创板首家半导体设备精密零部件上市公司。公司专注于金属材料零部件精密制造技术，掌握多种高端制造工艺，产品性能达国际主流标准，服务于国内外半导体设备龙头企业。

[富创精密官网](#)

3 宁波江丰电子材料股份有限公司【300666】

公司信息

企业状态	存续	注册资本	26541.6083万人民币
企业总部	宁波市	行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
法人	姚力军	统一社会信用代码	91330200772311538P
企业类型	其他股份有限公司(上市)	成立时间	1113408000000
品牌名称	宁波江丰电子材料股份有限公司	经营范围	一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属铸造；金属材料制造；新材料技术研发；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能基础资源与技术平台(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：检验检测服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

财务数据分析

财务指标	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024(Q1)	2024(Q2)
销售现金流/营业收入	0.98	0.96	0.95	0.99	0.91	0.95	0.91	1	0.9	/	/
扣非净利润同比增长(%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
资产负债率(%)	55.856	55.2486	35.5052	57.3541	52.9051	54.0319	49.4806	21.6141	34.1511	/	/
营业总收入同比增长(%)	18.6923	52.2135	24.2129	18.1187	26.9795	41.4051	36.6356	45.7971	11.8864	/	/

归属净利润同比增长(%)	24.9382	130.4101	16.552	-8.1612	9.1439	129.2846	-27.5479	148.7226	-3.353	/	/
摊薄净资产收益率(%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
实际税率(%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
应收账款周转天数(天)	71.9453	62.2956	67.8771	68.9682	74.1351	72.4579	70.1896	62.1929	76.6133	/	/
预收款/营业收入	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
流动比率	1.1664	1.2648	2.3187	1.1548	1.2325	1.1254	1.7698	3.6871	2.2461	/	/
每股经营现金流(元)	0.22	0.37	0.1811	0.0234	0.4326	-0.2029	0.4521	0.0621	0.9457	/	/
毛利率(%)	31.7438	31.8395	31.6529	29.5966	31.0608	28.0954	25.5604	29.9324	29.2024	/	/
流动负债/总负债(%)	63.1291	67.76	60.6652	94.352	86.2137	84.4555	58.5754	72.1261	59.6388	/	/
速动比率	0.6149	0.7336	1.4318	0.8328	0.6967	0.627	1.0698	2.3501	1.3924	/	/
摊薄总资产收益率(%)	4.3939	9.2505	8.3263	5.0114	4.3815	7.4577	3.7678	5.9442	3.882	/	/
营业总收入滚动环比增长(%)	/	25.1877	15.8243	4.2421	15.7646	3.0133	/	/	/	/	/
扣非净利润滚动环比增长(%)	/	/	-3.8819	-68.105	577.9165	-94.5585	/	/	/	/	/
加权净资产收益率(%)	10.71	20.96	14.98	9.98	9.95	17.15	8.77	11.41	6.25	/	/
基本每股收益(元)	0.15	0.33	0.33	0.27	0.29	0.67	0.47	1.11	0.96	0.22	0.61
净利率(%)	7.9853	12.3052	11.5618	8.9662	7.7271	12.2653	6.2322	10.2145	8.4731	/	/
总资产周转率(次)	0.5502	0.7518	0.7202	0.5589	0.567	0.608	0.6046	0.5819	0.4582	/	/
归属净利润滚动环比增长(%)	/	-2.4143	40.9043	-33.8701	68.9407	-46.1555	/	/	/	/	/
每股净资产(元)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
每股公积金(元)	0.1947	0.1947	0.8628	0.8628	0.9406	2.0519	2.7072	11.7508	11.5349	/	/
扣非净利润(元)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
存货周转天数(天)	177.3574	133.3136	129.0184	149.5948	176.7826	177.506	165.4792	182.2508	210.1454	/	/
营业总收入(元)	290912881.1	442808748.02	550025687.03	649683244.58	824964791.18	1166542634.09	1593912652.91	2323878581.81	2601608568.67	772389035.94	1627437290.3
每股未分配利润(元)	0.2096	0.5099	0.6453	0.8296	1.0286	1.5305	1.792	2.3224	2.9286	/	/
稀释每股收益(元)	0.15	0.33	0.33	0.27	0.29	0.66	0.47	1.11	0.96	0.22	0.61
归属净利润(元)	23844777.14	54940766.33	64034567.92	58808599.14	64185986.25	147168583.7	106626738.28	265204791.62	255474568.79	59646089.58	161133297.2
扣非每股收益(元)	0.09	0.27	0.26	0.2	0.15	0.28	/	/	/	/	/
毛利润(元)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
经营现金流/营业收入	0.22	0.37	0.1811	0.0234	0.4326	-0.2029	0.4521	0.0621	0.9457	/	/

公司竞争优势

■ 竞争优势

公司主要专注于超高纯金属溅射靶材、半导体精密零部件的研发、生产和销售。公司生产的半导体设备金属类零部件产品包括设备制造零部件和工艺消耗零部件，主要用于超大规模集成电路芯片领域。

江丰电子官网

附录

法律声明



权利归属：头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及其它法律保护。

尊重原创：头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。

内容使用：未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：support@leadleo.com。

合作维权：头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、提起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。

完整性：以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未仔细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。

业务合作

- ◆ 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：**报告库、募投、市场地位确认、二级市场数据引用、白皮书及词条报告**等产品，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等。
- ◆ 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展。

合作类型

会员账号

阅读全部原创报告和百万数据

定制报告/词条

募投可研、尽调、IRPR等研究咨询

白皮书

定制行业/公司的第一本白皮书

招股书引用

内容授权商用、上市

市场地位确认

赋能企业产品宣传

云实习课程

丰富简历履历

13080197867 李先生

18129990784 陈女士

www.leadleo.com

深圳市华润置地大厦E座4105室

诚邀企业 共建词条报告

- 企业IPO上市招股书
- 企业市占率材料申报
- 企业融资BP引用
- 上市公司市值管理
- 企业市场地位确认证书
- 企业品牌宣传 PR/IR

词

